

2025年度 第1四半期 決算説明資料

2025.7.17

将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与える重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

(単位: 百万円)	FY2025 1Q
売上高	89,914
売上総利益	61,261
GP率	68.1%
販売管理費	26,780
営業利益	34,480
経常利益	33,999
経常利益率	37.8%
税前利益	33,652
純利益	23,767

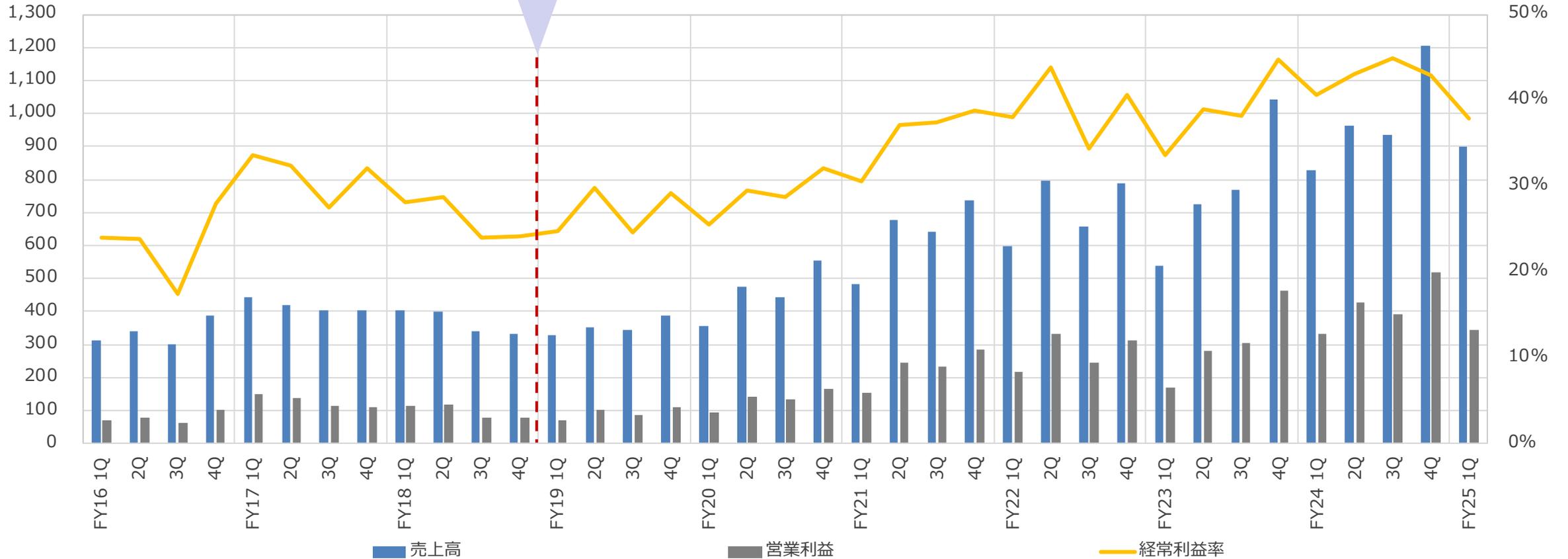
FY2024 4Q	QoQ	
	差額	(%)
120,716	-30,802	-25.5%
84,218	-22,958	-27.3%
69.8%	-1.7p	-
32,482	-5,702	-17.6%
51,735	-17,256	-33.4%
51,863	-17,864	-34.4%
43.0%	-5.2p	-
51,504	-17,851	-34.7%
38,638	-14,871	-38.5%

FY2024 1Q	YoY	
	差額	(%)
82,799	7,115	8.6%
57,699	3,562	6.2%
69.7%	-1.6p	-
24,322	2,459	10.1%
33,376	1,103	3.3%
33,623	376	1.1%
40.6%	-2.8p	-
33,457	195	0.6%
23,713	54	0.2%

売上高: YoY 高水準の出荷を背景に検収も進捗し増収
 GP率: YoY 高付加価値製品が貢献した一方で為替影響等により低下
 販売管理費: YoY 人件費や研究開発費を中心に増加

(単位：億円)

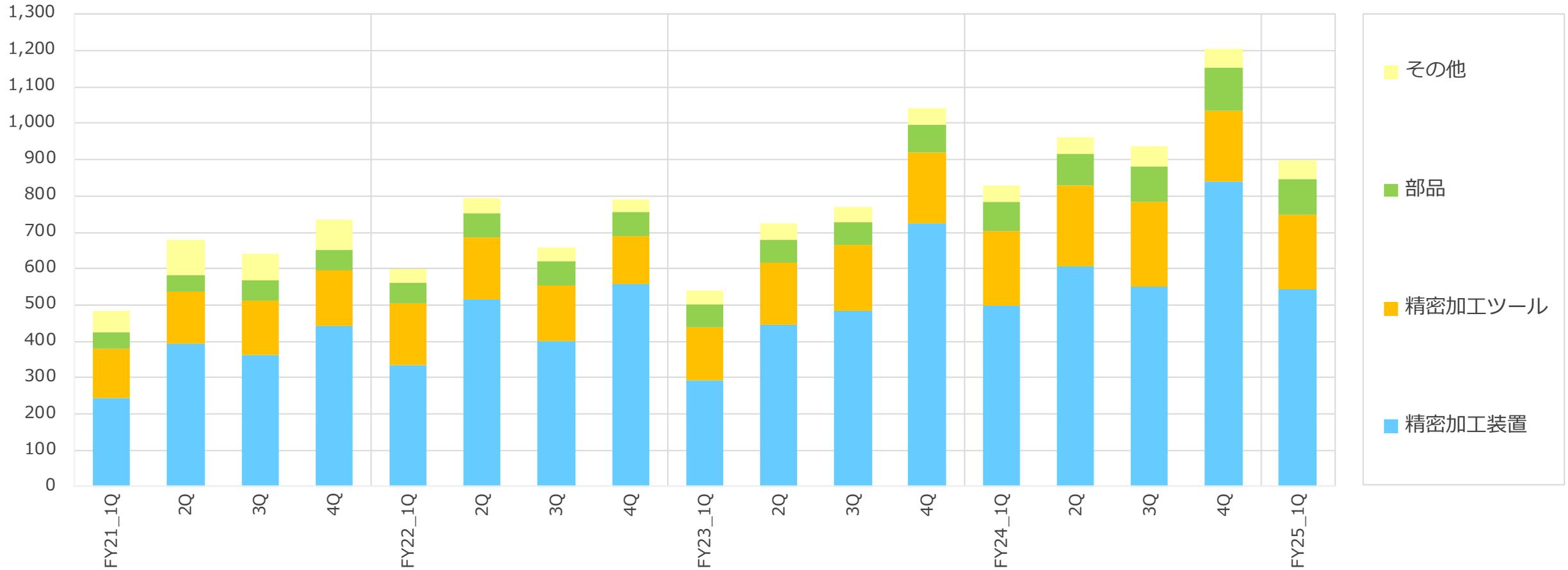
会計方針変更により
収益認識のタイミングを検収時に変更



6 四半期ぶりに営業利益率40%を割り込むが依然高水準で推移
(FY25_1Q 営業利益率38.3% 経常利益率37.8% 純利益率26.4%)

製品群別売上高 四半期推移

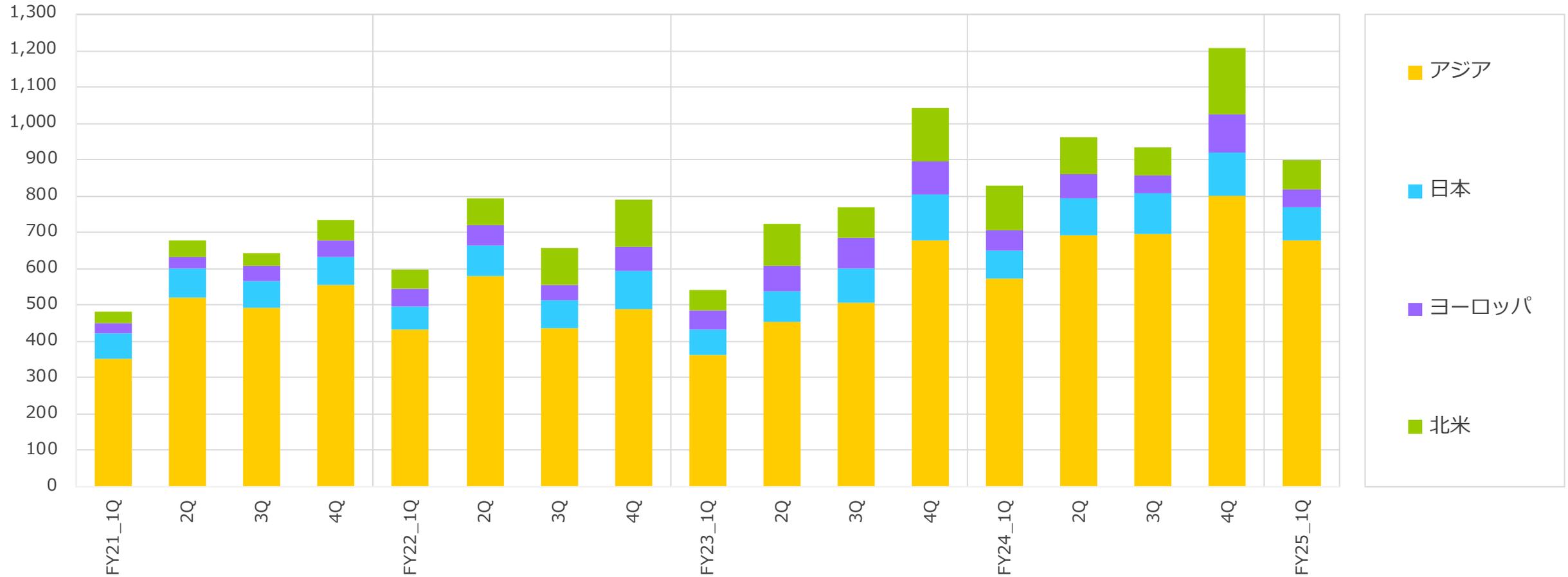
(単位：億円)



※構成比数値は、Webサイト「補足情報」に記載

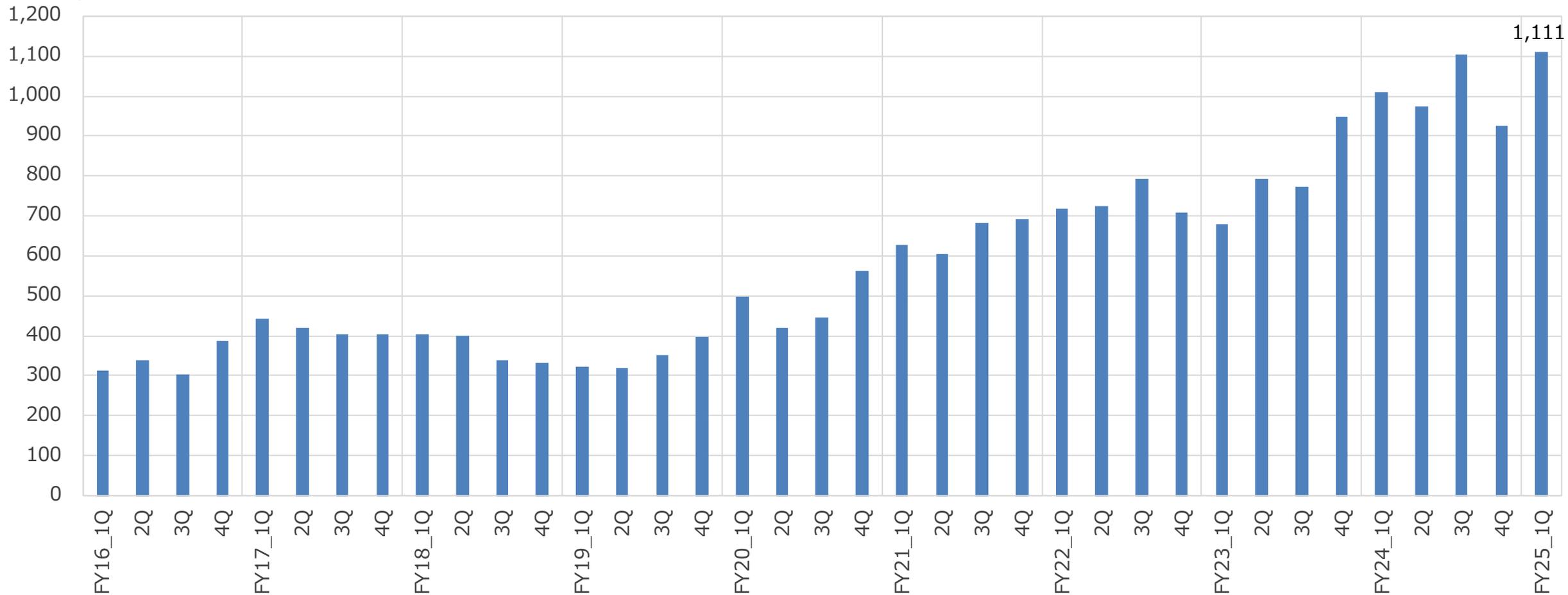
地域別売上高 四半期推移

(単位：億円)



FY25_1Q 海外売上高比率 89.9%

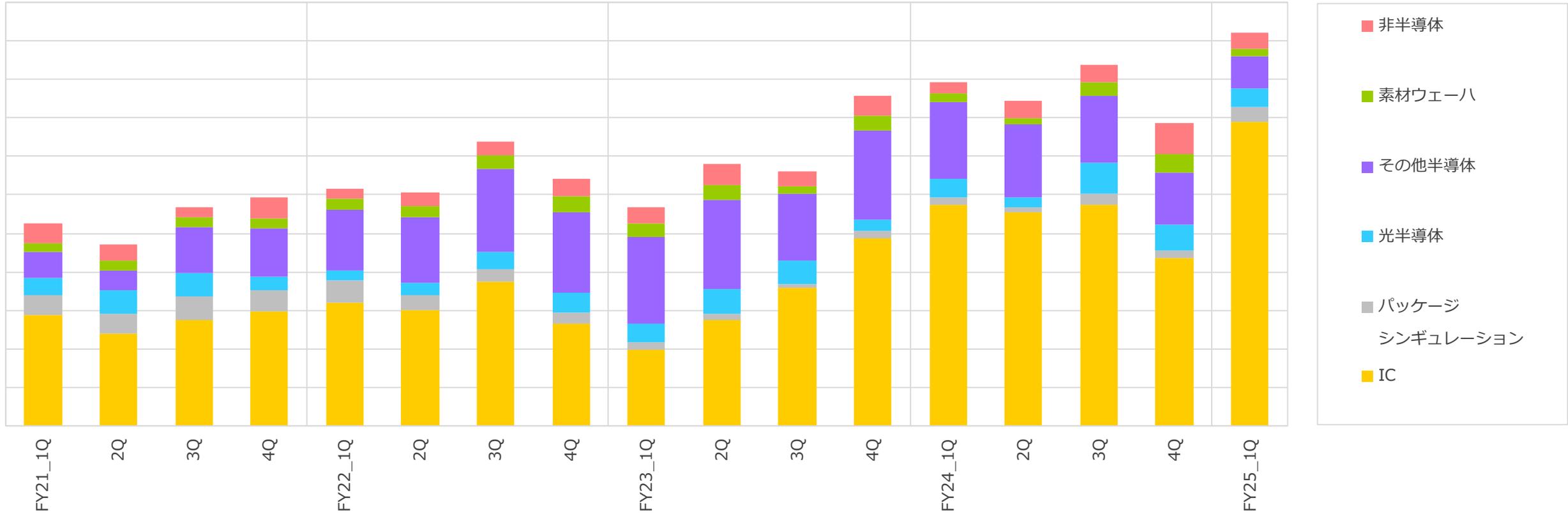
(単位：億円)



FY25_1Q 出荷額 約1,111億円

出荷額ベース

精密加工装置

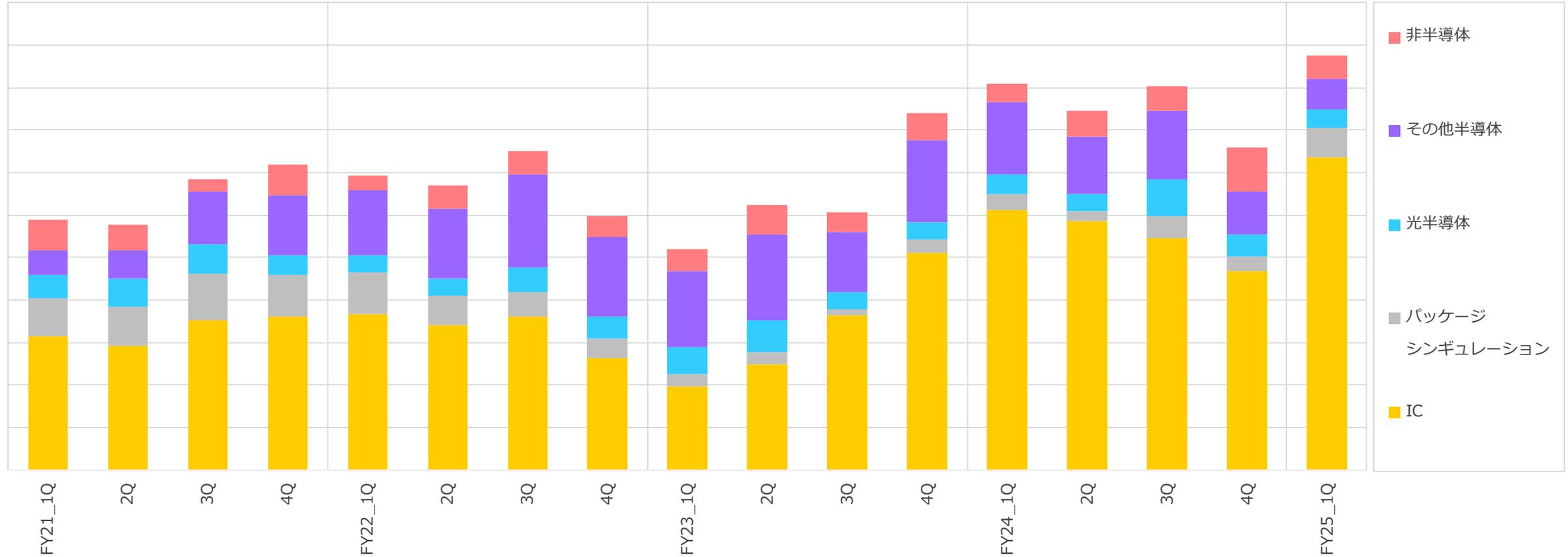


QoQ
YoY

生成AI向けを中心にICが増加し、装置全体では過去最高を更新
 パワー半導体（その他半導体）は減少した一方、生成AI向けを中心にICは増加

出荷額ベース

ダイサ

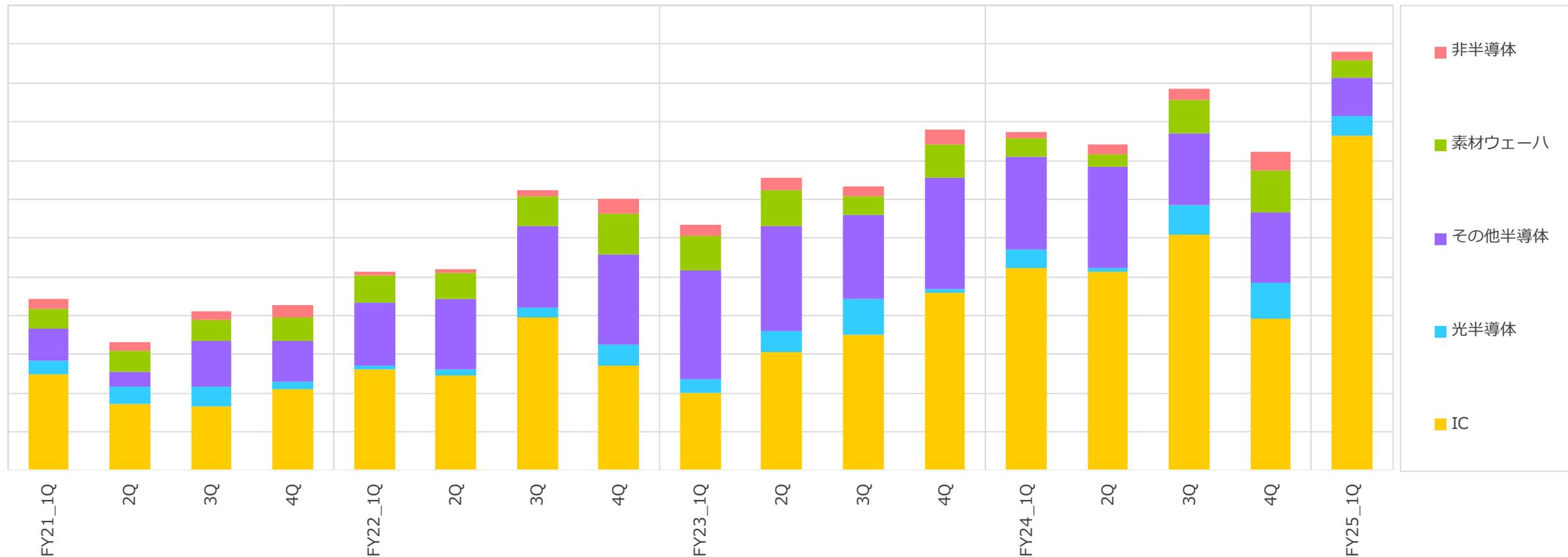


QoQ 生成AI向けを中心にICが増加

YoY パワー半導体（その他半導体）は減少した一方、生成AI向けを中心にICは増加

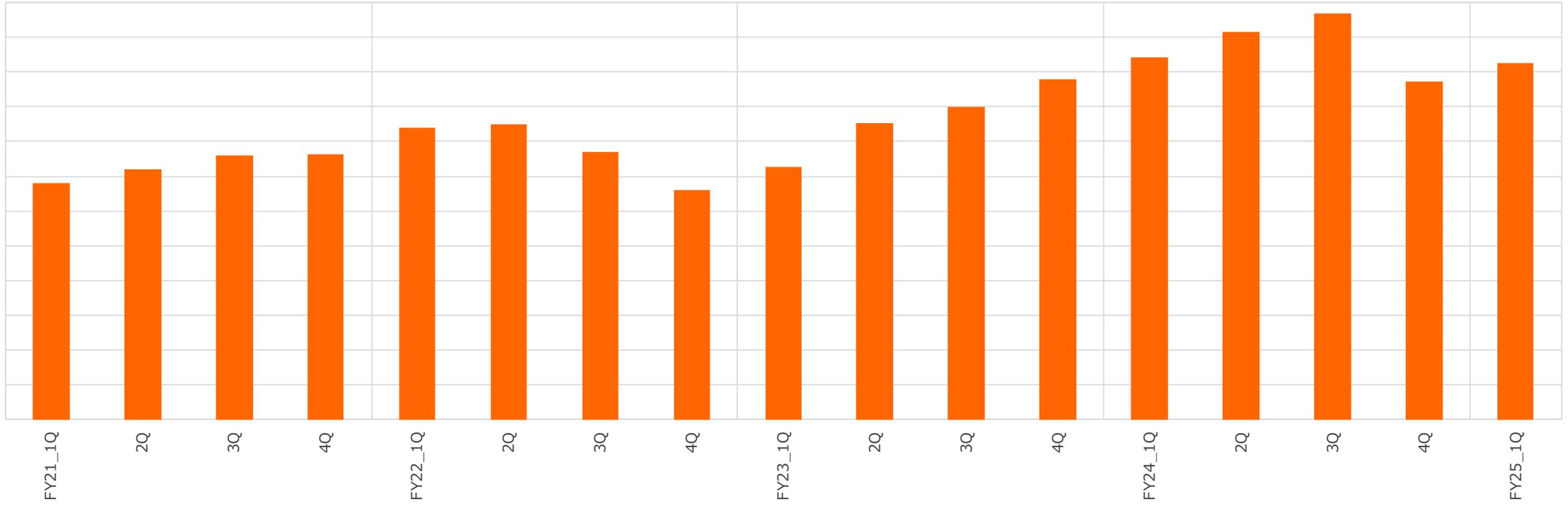
出荷額ベース

グラインダ



QoQ 生成AI向けを中心にICが増加

YoY パワー半導体（その他半導体）は減少した一方、生成AI向けを中心にICは増加



顧客の設備稼働率等を背景に底堅く推移

(単位：百万円)	FY2025 1Q	FY2024 4Q	差額
現金及び預金	198,498	229,167	-30,668
受取手形・売掛金	47,952	43,178	4,774
棚卸資産	141,134	139,002	2,132
流動資産	391,070	424,502	-33,431
有形固定資産	206,601	204,014	2,587
固定資産	229,008	229,585	-577
総資産	620,079	654,087	-34,008
流動負債	134,120	160,392	-26,273
固定負債	1,040	991	49
負債合計	135,160	161,383	-26,224
純資産	484,918	492,703	-7,784
負債純資産合計	620,079	654,087	-34,008
自己資本比率	78.0%	75.1%	2.9p

総資産：配当金など各種支払いにより現預金が大きく減少

負債：主に未払法人税等や賞与引当金の影響で減少

純資産：主に配当金支払いにより減少

(単位：億円)

今回予想

	FY24 1Q	2Q	3Q	4Q	FY25 1Q	2Q
売上高	828	962	936	1,207	899	912
営業利益	334	426	391	517	345	332
経常利益	336	414	420	519	340	332
純利益	237	297	318	386	238	235
営業利益率	40.3%	44.3%	41.8%	42.8%	38.4%	36.4%
経常利益率	40.6%	43.0%	44.9%	43.0%	37.8%	36.4%
純利益率	28.6%	30.9%	34.0%	32.0%	26.5%	25.8%
出荷額	1,011	976	1,103	925	1,111	836

※億円未満 四捨五入

想定為替レート 2Q (7-9月期)
為替感応度 (年換算)

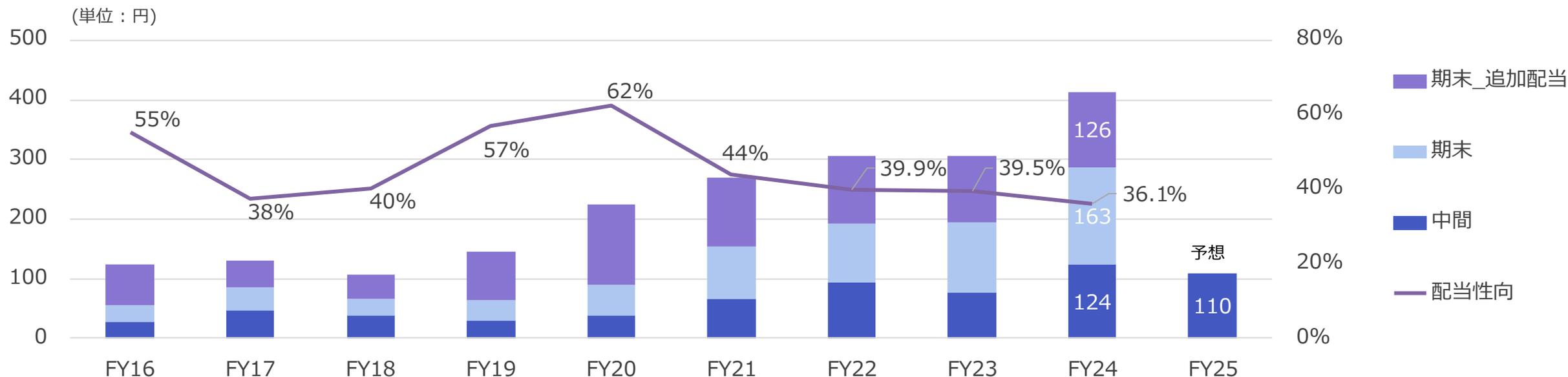
US\$: 135円
US\$: 約16億円

Euro : 160円
Euro : 約1億円

【配当方針】

1. 期末、中間の年2回、連結半期純利益の25%を配当する
2. 安定配当として半期10円（年間20円）を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 年度末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする（追加配当）

*技術購入予備費（技術特許購入、ベンチャーへの出資等）および設備拡張資金、有利子負債返済資金など



FY25 予想 中間：110円 期末：未定

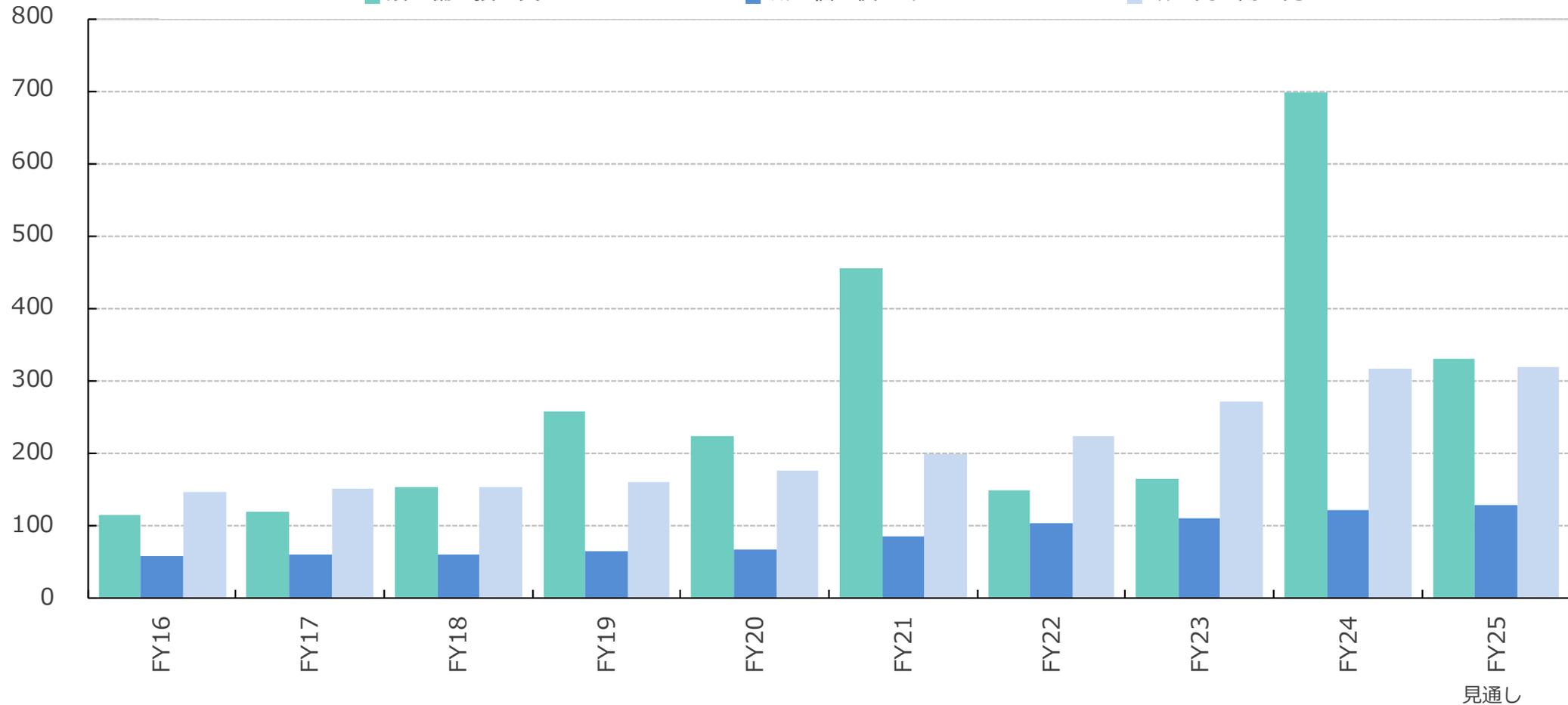
※2023年4月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施
(FY22以前の配当推移は当該株式分割が行われたと仮定して記載)

(単位：億円)

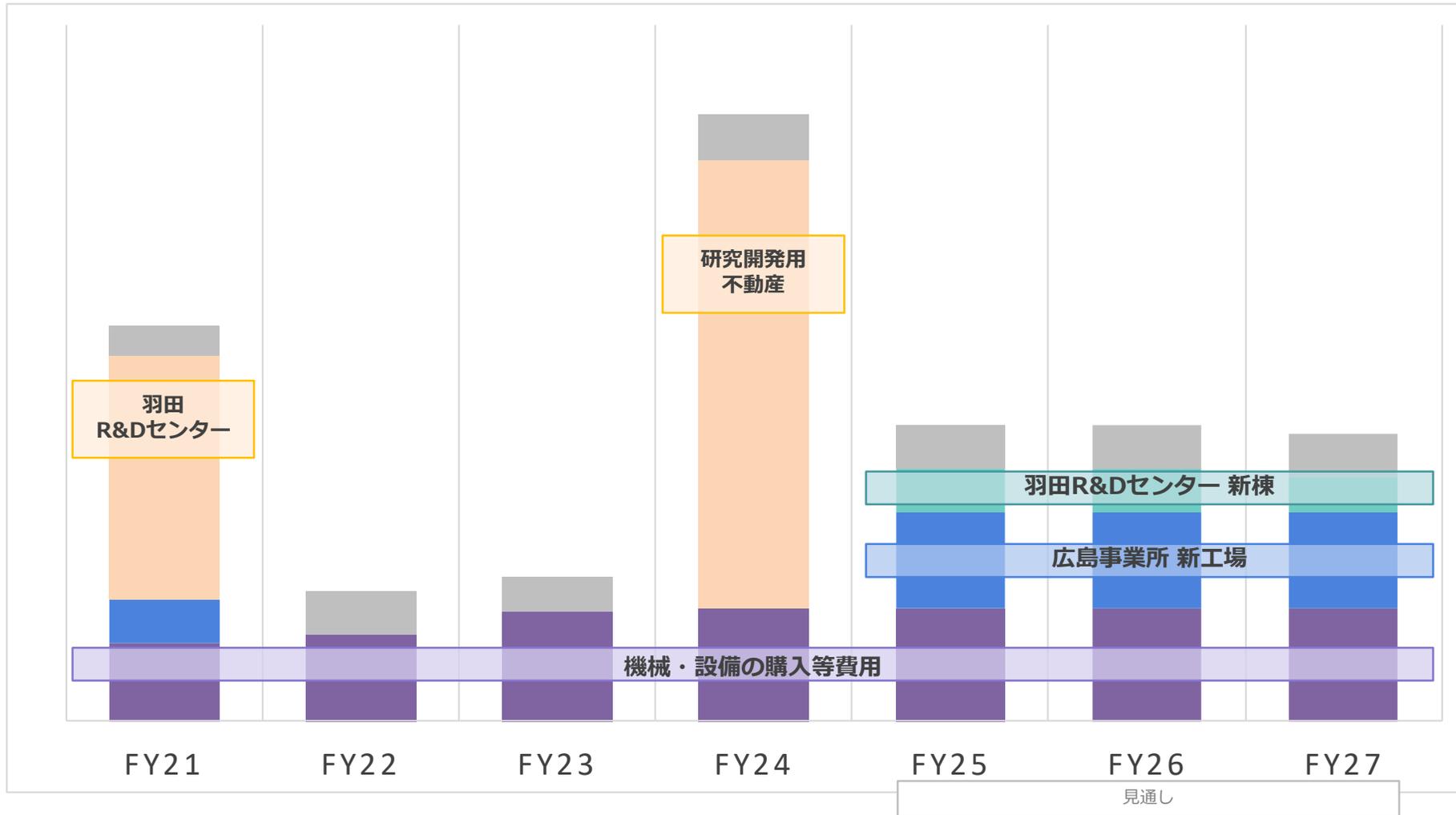
■ 設備投資

■ 減価償却

■ 研究開発



FY25見通し 設備投資：約330億円 合理化投資、羽田R&Dセンター建替、新工場建築を含む
 減価償却：約130億円
 研究開発：約320億円 積極的な研究開発活動を継続



研究開発用不動産
 羽田R&Dセンター 新棟
 広島事業所 新工場

約500億円
 約140億円
 約330億円

支出時期：FY24
 支出時期：FY25~FY27
 支出時期：FY25~FY27

出荷額ベース

製品群		見通し FY25_2Q 増減率 (QoQ)
精密加工装置	ブレードダイサ	-30%
	レーザーソー	-45%
	ダイサ	-35%
	グラインダ	-35%
	周辺装置	-25%
精密加工装置		-35%
精密加工ツール		5%
その他		-15%

【ご参考】 製品群別 用途別 データ集

出荷額ベース

■ 製品群	1Q		
	構成比	QoQ	YoY
精密加工装置合計	68%	28%	14%
内、ダイサ	35%	29%	7%
ブレードダイサ	18%	38%	5%
レーザソー	18%	20%	10%
内、グラインダ	29%	31%	24%
内、周辺装置	3%	4%	5%
精密加工ツール	19%	5%	-1%
その他	14%	8%	9%
出荷額合計	100%	20%	10%

出荷額ベース

製品	用途	FY24				FY25
		24-1Q	24-2Q	24-3Q	24-4Q	25-1Q
ダイサ	1_IC	67%	69%	60%	62%	78%
	2_パッケージ・シンギュレーション	4%	3%	6%	4%	5%
	3_光半導体	5%	5%	10%	7%	5%
	4_その他_半導体	19%	16%	18%	13%	7%
	5_非半導体	5%	7%	7%	14%	6%
ダイサ		100%	100%	100%	100%	100%
グラインダ	1_IC	60%	61%	62%	48%	80%
	2_光半導体	6%	1%	8%	11%	5%
	3_その他_半導体	27%	31%	19%	22%	9%
	4_素材ウエーハ	6%	4%	9%	14%	4%
	5_非半導体	2%	3%	3%	6%	2%
グラインダ		100%	100%	100%	100%	100%

出荷額ベース

		FY24				FY25
製品	用途	24-1Q	24-2Q	24-3Q	24-4Q	25-1Q
ダイサ	1_IC	210%	135%	50%	-8%	23%
	2_パッケージ・シミュレーション	23%	-15%	270%	7%	33%
	3_光半導体	-26%	-46%	112%	26%	-5%
	4_その他_半導体	-3%	-33%	15%	-48%	-58%
	5_非半導体	-17%	-13%	26%	65%	34%
ダイサ		75%	36%	49%	-10%	7%
グライнда	1_IC	160%	68%	73%	-14%	66%
	2_光半導体	46%	-86%	-15%	819%	-1%
	3_その他_半導体	-16%	-4%	-15%	-37%	-59%
	4_素材ウエーハ	-45%	-62%	79%	26%	-8%
	5_非半導体	-50%	-24%	19%	31%	46%
グライнда		37%	11%	34%	-6%	24%

出荷額ベース

		FY24				FY25
製品	用途	24-1Q	24-2Q	24-3Q	24-4Q	25-1Q
ダイサ	1_IC	20%	-4%	-7%	-14%	62%
	2_パッケージ・シグネーチャ	14%	-34%	119%	-35%	43%
	3_光半導体	10%	-12%	115%	-40%	-16%
	4_その他_半導体	-11%	-22%	19%	-37%	-28%
	5_非半導体	-34%	46%	-3%	77%	-47%
ダイサ		8%	-7%	7%	-16%	29%
グライнда	1_IC	14%	-2%	18%	-35%	120%
	2_光半導体	402%	-85%	952%	20%	-46%
	3_その他_半導体	-17%	10%	-29%	-3%	-46%
	4_素材ウエーハ	-45%	-29%	148%	29%	-59%
	5_非半導体	-59%	62%	24%	61%	-55%
グライнда		-1%	-4%	17%	-16%	31%

検収ベース

■ 構成比	FY2024				FY2025
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
日本	9%	11%	12%	10%	10%
アメリカ	15%	10%	8%	15%	9%
アジア	69%	72%	74%	66%	75%
シンガポール	6%	8%	8%	7%	7%
台湾	16%	17%	19%	22%	27%
韓国	14%	12%	9%	9%	9%
中国 ※	32%	33%	37%	27%	30%
その他	1%	1%	1%	2%	3%
ヨーロッパ	7%	7%	5%	9%	6%
合計	100%	100%	100%	100%	100%

※外資メーカー現地工場向け含む

本資料について

掲載内容に関しては細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や第三者によるデータの改ざん等に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。また、本資料は投資勧誘を目的にしたものではありません。投資はご自身の判断において行われるようお願いいたします。

表記について

年間の会計期間である4月～翌年3月までをFY (Fiscal Year) と表記し、四半期の会計期間は4-6月を1Q、7-9月を2Q、10-12月を3Q、1-3月を4Qと表記しています。
金額単位に応じて、単位未満の金額を四捨五入または切り捨て処理しており合計値が合わない場合があります。
%は実際の金額を基に算出しています。

将来の見通しに関する注意事項

この資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。実際の業績はさまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。実際の業績に影響を与えうる重要な要素には世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

英語圏の方々のために英語資料を提供する場合、和文 (原文) と英訳の内容が相違した際は和文の内容が優先されます。

本資料の著作権は当社に帰属しており、無断での転載は禁じられています。私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、本資料を使用 (複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む) するためには、当社の事前の明示の許諾が必要です。

<https://www.disco.co.jp/>